

东科半导体2025年度社会招聘需求

| 序号 | 招聘岗位 | 岗位职责 | 年龄要求 | 性别要求 | 专业要求 | 学历要求 | 经验 | 岗位要求 | 工作地点 |
|----|---------------|--|--------|------|-------------------|---------|------|---|-------------------------------------|
| 1 | 模拟IC设计专家 | 1. 负责模拟IC团队的管理及技术指导； 2. 负责芯片项目模拟部分的设计全流程，参与设计并指导模拟IC团队完成项目目标； 3. 根据产品需求，分解及定义模拟部分各个模块的功能和性能指标； 4. 负责模拟电路设计、仿真验证、迭代优化，并完成相关文档； 5. 负责版图布局，指导layout工程师完成版图设计，确保版图达到电路设计的要求； 6. 参与芯片测试与系统测试； 7. 指导芯片量产化工作； | 不超过45岁 | 男 | 集成电路相关 | 本科及以上学历 | 5年以上 | 1. 具有模拟集成电路相关专业本科以上学历，研究生学历优先； 2. 一年以上工作经验，有量产产品研发经验，担任过模拟IC技术负责人或技术总监会优先； 3. 有深厚的模拟IC设计经验，熟悉模拟IC产品化全流程，包括设计、仿真、版图、测试等，精通数模混合设计的流程； 4. 熟悉国内外主要代工厂的工艺特点； 5. 精通主流设计工具，会使用工具进行必要的架构仿真； 6. 精通基础模拟模块的设计； 7. 具有团队人才培养和平台建设的能力； 8. 有能力对芯片研发中遇到的问题及时 | 北京分公司 无锡分公司 |
| 2 | 模拟IC设计工程师（资深） | 1. 负责模拟芯片的定义，开发和验证等开发安全过程以及产品升级； 2. 根据产品定义和技术规范设计具体的电路架构，独立完成模拟电路设计、仿真、验证等； 3. 能够合理制定项目计划，按时保质完成项目计划； 4. 规划版图布局，指导layout工程师完成版图设计，确保版图达到电路设计的要求； 5. 负责制定Test Plan规范，与测试工程师共同解决lab测试和ATE测试过程中遇到的问题； 6. 对产品前后端环节负责和追踪，负责相关设计文档的撰写。 | 不超过50岁 | 男 | 电子信息类 | 硕士研究生 | | 1. 985、211院校优先 2. 有芯片量产经验者优先，掌握良好的芯片及系统可靠性设计方法； 3. 对高压半导体器件以及工艺流程有比较深入了解，深刻理解CMOS/BCD工艺； 4. 精通AC-DC开关电源芯片设计，具备Flyback, LLC, AHB, PFC等拓扑设计经验。 | 青岛分公司 北京分公司 无锡分公司 |
| 3 | AE工程师 | 1. 配合上级主管的管理工作，完成上级安排的相关任务 2. 协助FAE工程师完成产品样品的开发、制作、测试，完成产品化过程的各项技术指标调试； 3. 开关电源规范和EMI设计和调试经验 4. 会使用AD软件，熟悉各类电子元器件及测试设备的使用 5. 熟悉电源中各零部件的规格、特性和选型，有较强的电路分析能力，熟悉电源可靠性 | 不超过40岁 | 男 | 电子、集成电路、自动化、仪器与测量 | 本科及以上学历 | 3年以上 | 1、熟练使用PCB画图软件，AD, PADS等； 2、熟练使用电路仿真软件；对开关电源各种基本拓扑熟悉，能推导基本公式，计算元器件参数等； 3、3年以上开关电源应用经验，能独立完成领导交代的项目； | 无锡分公司 |
| 4 | FAE工程师 | 1、协助产品推广； 2、产品的售前售后服务； 3、负责相应产品的应用文档（应用设计指南等）的制定和输出； 4、提供产品应用过程中的问题解答和技术支持，主要方向包括AC-DC开关电源芯片，同步整流芯片等。 5、拥有氯化镍AC-DC电源产品设计经验，熟练掌握FLYBACK, BUCK, PFC, LLC, AHB等电源拓扑，从理论计算到仿真，样机设计全部精通； 6、拥有同行工作经验优先；管理经验优先； 7、能够适应经常出差； | 不超过40岁 | 男 | 电力电子、自动化控制类 | 本科及以上学历 | 3年以上 | 1、熟练使用PCB画图软件，AD, PADS等； 2、熟练使用电路仿真软件；对开关电源各种基本拓扑熟悉，能推导基本公式，计算元器件参数等； 3、5年以上开关电源应用经验，能独立完成领导交代的项目； | 无锡分公司 |
| 5 | 协议单片机软件工程师 | 1. 负责 PD 协议的程序编程，撰写与维护 2. 参与新产品和新项目系统架构设计规划和新产品方案设计，负责产品新功能开发的跟踪和解决，编写项目相关的技术文档 3. 能独立处理和解决所负责的项目 4. 熟悉各类快充协议 5. 与硬件工程师协调、沟通工作，支持和推进客户产品顺利量产 | 不超过40岁 | 男 | 计算机、电子、通信类相关 | 本科及以上学历 | 1年以上 | 1、精通C语言，熟练使用仿真开发工具 2、熟悉各类快充协议经验要求：1年以上工作经验 3、具有良好的数学基础和逻辑思维力，具有上进心，有较强的自学能力，工作认真负责，有较强的敬业精神和抗压能力 | 深圳分公司 无锡分公司 |
| 6 | 工艺工程师 | A.工艺开发与优化： 1. 负责芯片封装（diebond/wirebond）及测试工艺的开发、调试与优化 2. 分析生产过程中的异常问题（如封装分层、金线断裂、良率波动等），提出改进方案并验证。 B.量产支持： 1. 监控生产线良率、效率及成本，主导工艺参数标准化及稳定性提升。推动自动化与工艺整合，降低生产成本并提高产能。 2. 新技术导入：参与新封装技术（的评估、开发及量产导入，配合研发团队完成新产品的工艺可行性分析与风险管控。 3. 跨部门协作：与设备、质量、研发等部门协作，解决工艺与设备兼容性问题，确保产品符合客户规格。 | 不超过45岁 | 男 | 理工科专业 | 专科及以上 | 3年以上 | 1. 专科及以上学历，材料科学、微电子、机械工程、电气工程、自动化等相关专业。 2. 3年以上芯片封装行业工艺开发经验，熟悉传统封装（DFN、QFN、BGA、TO、SOP、ESOP）工艺流程。 | 安徽马鞍山 |
| 7 | 设备工程师 | 岗位职责： 1. 负责粘片、测试或焊线任一具体工序设备的维护、保养、故障排除 2. 负责相关工序工艺的改善、品质提升 3. 负责工艺文件、作业指导书的编写 4. 负责带领机修技术团队做好生产服务工作 | 不超过45岁 | 男 | 理工科专业 | 专科及以上 | 3年以上 | 任职要求： 1. 粘片、测试、焊线工序3年以上同行业工作经验 2. 对粘片工序工艺制程熟悉、具有sop编写、工艺改善、产品质量提升能力 3. 熟悉工序相关机台（ASM、华峰等），具有维修处理机台故障能力 | 安徽马鞍山 |
| 8 | FT测试工程师 | 人员要求： 职责： 1. 根据我司芯片设计工程师要求，开发出符合要求的测试程序并负责独立调试 2. 配合我司产品应用工程师，完成测试程序升级与测试时间优化工作 3. 完成NPI 导入阶段的产品资料收集，并能够在完成产品开发后输出相关的产品开发总结报告 4. 能够对比相同产品在不同测试平台上的数据差异，保持与芯片设计工程师之间沟通，优化测试方案，保证产品稳定性与可靠性 | 不超过40岁 | 男 | 电子、集成电路、自动化、仪器与测量 | 本科及以上学历 | 5年以上 | 1. 电子、通信、微电子类专业背景，本科及本科以上学历、5年以上 ATE 开发经验 2. 有独立参与整个 ATE 测试早期的测试需求输出以及程序开发经验，能够完成对ATE 测试工程师的相关技能培训 3. 熟悉Load Board选型，可以根据不同测试规范选择适合的测试平台、有一定模拟电路基础，熟悉C/C++程序开发语言、至少熟悉华峰 STS8200B 等一种及以上主流测试机操作 | 安徽马鞍山 或其他分公司 能接受经常出差、在 马驻场 |